

Willkommen bei O-Leading

Wir sind ein professioneller Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Die Produktpalette umfasst ein-, doppelseitige, mehrschichtige Leiterplatten, flexible Leiterplatten und MCPCBs. Wir bieten einen schnellen Prototypenservice - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Arbeitsstunden Produktionszeit.

☐☐ [Golden Fingers PCB Hersteller China](#) ☐☐

KUPFERPLATTENLÖCHER MINDESTENS .025 AVG, .020 MIN .. LÖCHER DÜRFEN NICHT STECKEN

Packen Sie mit farblosem transparentem Luftpolsterfolie, 25 Stück / Beutel, setzen Sie das Trockenmittel in die Flanke und legen Sie die Feuchtigkeitsanzeigekarte auf die Oberseite

Bitte klicken Sie hier für weitere Informationen:

Produktbeschreibung

- [PCB Assembly Hersteller China](#)

PCB P / N.	O-LEADING33689
Ebenenanzahl	2L
Material	FR-4
Board thk	1,60 mm
Kupfer thk	1 / 1oz
Kleinste Lochgröße	0,2 MM
Anzahl der Löcher (Stk.)	30
Impedanzregelung. J / N (Tol%)	N.







Zertifizierungen



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
 Certificate No: 16118Q10347R05

We hereby certify that
O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED
 Credit No: 61691591-000-07-17-2
 Registration Add: ROOM 603D 6/F HANG PONT COMMERCIAL BUILDING,31 TONKIN ST,CHEUNG SHA WAN,KL, HK
 Business Add: 1313 Floor 13 Fortune Building, Danstui Town Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System**
 Which fulfills the requirements of the following standards
 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification
 Sales of printed circuit boards

Initial Issuance period: February 27, 2018
 This certificate is valid during: February 27, 2018 -- February 26, 2021
 This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

First supervision and audit	Qualified mark	Second supervision and audit	Qualified mark
-----------------------------	----------------	------------------------------	----------------

The certification registration scope shall include those products/services scopes which fall to be covered by the relevant effective administrative permission and qualification permission required by the state. The effectiveness of this certificate shall be evaluated by annual surveillance audit of CICC. The certificate shall be valid when used together with the surveillance audit conclusion. The related information of this certification can be searched at the public website of company www.cicc.com.cn.

201726 201VZL430354 - Wiring, Printed - Component

UL ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [UL Product Databases](#).
 Click on a product designation for complete information.
[Page Bottom](#)

Wiring, Printed - Component

[See General Information for Wiring, Printed - Components](#)

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED 4190354

Fortune Building, Nanheng West Road
 Room 1313
 Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

	Cond Width			SS/ DS/	Area Diam	Solder		Temp		Flame	RoHS	C
	Min	Max	Min			Max	Class	DSR				
Typ	max(in)	mm(in)	mic(mil)	DSO	mm(in)	C	sec	C	Class	DSR	I	
Multi-layer (mass laminate) printed wiring boards.												
O-LEADING-401												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-	
O-LEADING-407												
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.2 (0.4)	260	10	170	V-0	NI	-	
Multi-layer printed wiring boards.												
O-LEADING-408												
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) min:1.35	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	NI	*	
Single layer printed wiring boards.												
O-LEADING-002												
	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	NI	-	
O-LEADING-003												
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-	
O-LEADING-033												
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	S5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	NI	-	
O-LEADING-205												
	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	
O-LEADING-206												
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.
 Last updated on 2017-01-27

Questions? [Print this page](#) [Terms of Use](#) [Page Top](#)

[http://www.ul.com/ulcertification/2017VZL430354/Wiring,Printed-Component](#)



Test Report No. CANEC1805164701 Date: 03 Apr 2018 Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**
 SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2014+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is pleased to announce that it has been awarded the ISO 9001:2015 certification for its services of testing, inspection, and certification. SGS is a leader in the field of testing, inspection, and certification services. SGS is a member of the International Organization of Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC). SGS is a member of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) and the International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP). SGS is a member of the International Union of Pure and Applied Mathematics (IUPM) and the International Union of Pure and Applied Biology (IUPAB). SGS is a member of the International Union of Pure and Applied Geology (IUPG) and the International Union of Pure and Applied Meteorology (IUPM).

Member of the SGS Group (SGS SA)

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professioneller OEM-Leiterplattenhersteller
Lieferdetail	7-12 Tage



FAQ

1. Wie sichert O-Leading die Qualität? [Aluminium PCB Hersteller China](#)

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit Folgendem erreicht.

1. Der Prozess wird streng nach den Normen ISO 9001: 2008 kontrolliert.
2. Umfangreicher Einsatz von Software bei der Verwaltung des Produktionsprozesses
3. Standortprüfgeräte und -werkzeuge. Z.B. Flugsonde, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
4. Engagiertes Qualitätssicherungsteam mit Fehlerfallanalyseprozess
5. Kontinuierliche Schulung und Ausbildung des Personals

2. Wie hält O-Leading Ihren Preis wettbewerbsfähig?

In den letzten zehn Jahren hatten sich die Preise für viele Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Der RMB in chinesischer Währung hatte gegenüber dem US-Dollar um 31% aufgewertet. Auch unsere Arbeitskosten sind deutlich gestiegen. O-Leading hat jedoch unsere Preise stabil gehalten. Dies liegt ganz bei unseren Innovationen zur Kostensenkung, Vermeidung von Abfällen und Verbesserung der Effizienz. Unsere Preise sind in der Branche bei gleichem Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist für beide Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Vorteil in Bezug auf Kosten und Qualität bieten können.

3. Welche Arten von Boards kann O-Leading verarbeiten?

Gängige FR4-, High-TG- und Halogen-freie Platten, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminium / Kupfer-basierte Platten, PI usw.

4. Welche Daten werden für die Leiterplattenherstellung benötigt?

Es ist am besten, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können auch Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten?

Materialschneiden → Innen-Trockenfilm → Innen-Ätzen → Innen-AOI → Mehrfachbindung → Schichtaufbau
Pressen → Bohren → PTH → Plattenbeschichtung → Äußerer Trockenfilm → Musterbeschichtung →
Außenätzen → Äußere AOI → Lötmaske → Komponentenmarkierung → Oberflächenbeschaffenheit →
Arbeitsplan → E / T → Sichtprüfung.